

底部加热薄膜涂布机

货号: TB08



简介

适用于陶瓷晶体电池和纳米薄膜的底部加热薄膜涂布机，具备可调涂布速度、精准厚度控制、真空固定和加热干燥功能，温度范围为室温至150℃，可为可靠的实验室研究和材料加工应用提供可重复的结果

了解更多

应用	描述	主要优势
陶瓷薄膜研究	将陶瓷浆料或功能陶瓷材料涂覆到支撑基材上，用于高温成膜研究。	可控涂布速度和0.01 mm厚度控制精度有助于实现可重复的材料对比。
晶体薄膜开发	制备晶体相关薄膜，满足均匀浆料铺展和受控干燥条件的要求。	从室温至150℃的底部加热有助于建立明确的涂布后干燥条件。
电池电极制备	将电池材料浆料涂覆到铝箔或铜箔上，用于实验室电极和电芯制造研究。	真空固定可减少基材移动，可编程涂布行程有助于实现一致的电极制备。
特殊纳米薄膜研究	采用需要精确刮刀调节和受控运动的实验室涂布工艺开发特殊纳米薄膜。	精细涂布控制和可调速度使研究人员能够系统评估工艺变量。
先进材料研究	研究新兴材料在升温研究条件下的成膜行为和涂布条件。	涂布与加热功能的结合简化了小规模工艺开发。
学术与实验室工艺研究	为材料科学实验、配方筛选和对比测试制备可重复的涂布样品。	触摸屏参数设置、紧凑尺寸和自动涂布运动可提高工作流程效率。

参数	规格
型号	TB08
标准涂布装置宽度	100 mm
真空板	配备真空铝平板
配套真空泵	1台无油真空泵
控制系统	PLC与触摸屏控制
涂布行程设置	0至300 mm，通过触摸屏设置
电源	220 V / 50 Hz
重量	50 kg
外形尺寸	长550 mm × 宽350 mm × 高320 mm

参数	规格
涂布速度	0至120 mm/s，可调
刮刀厚度调节范围	0至5 mm
涂层厚度控制精度	0.01 mm
真空板加热与干燥系统	室温至150℃

参数	规格
温度控制器	数字显示温度控制器
温度控制精度	±1°C
真空板尺寸	长415 mm × 宽200 mm × 高32 mm

基材	宽度	厚度	面密度
铝箔	50至200 mm	10至50 μm	27至135 g/m²
铜箔	50至200 mm	6至20 μm	53至178 g/m²

步骤	操作
1	将电极片放置在真空板上，启动电源并开启真空，使电极片固定在真空板上。
2	将涂布装置放置在电极片上，并加入涂布浆料。
3	启动涂布循环。涂布装置会自动向前运行，完成涂布操作。
4	取下涂布装置和推杆，设置加热温度与时间，并进行加热干燥。
5	干燥完成后，取下涂布后的电极片，并将涂布装置复位。